POSITION DETECTOR AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

Publication number: JP2001264006 (A)

Publication date:

2001-09-26

Inventor(s):

HASHIGUCHI KENJI

Applicant(s):

KOGANEI LTD

Classification:

- international:

G01B7/00; F15B15/14; F15B15/28; G01D5/18; G01D5/245; G01B7/00; F15B15/00;

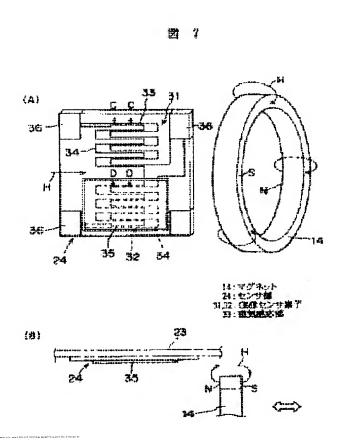
G01D5/12; (IPC1-7): G01B7/00; F15B15/14; F15B15/28; G01D5/18; G01D5/245

- European:

Application number: JP20000075057 20000317 **Priority number(s):** JP20000075057 20000317

Abstract of JP 2001264006 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To miniaturize a casing of an actuator for an air cylinder and the like. SOLUTION: This position detector is installed on the casing of the actuator, to detect the positions of a piston rod and a piston as reciprocating members mounted reciprocatingly. A magnet 14 is installed on the piston, a sensor part 24 with a GMR sensor element 31 sensitive to the magnetic force of the magnet 14 is installed on the flat detector installed on the casing. The flat detector is installed on the flat surface of the casing to detect the position of the piston rod.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-264006 (P2001-264006A)

(43)公開日 平成13年9月26日(2001.9.26)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FI			テーマコート*(参考)			
G01B	7/00			G 0 1	В	7/00		J	2F063	3
F15B	15/14	3 1 0		F 1 5	В	15/14		310	2 F 0 7 7	•
	15/28					15/28		L	3H081	_
								J		
G01D	5/18			G 0 1	D	5/18		L		
			審查請求	未請求	請求	項の数8	OL	(全 11 頁)	最終頁に	続く
(21)出願番号		特顧2000-75057(P2000-75057)		(71) 出	人類と	000145	611			
						株式会	社コガ	ネイ		
(22)出顧日		平成12年3月17日(2000.3.17)				東京都	千代田	区丸の内3丁	目2番3号	
				(72) 🕏	明者	看口 橋口	健二			
						東京都	千代田	区丸の内3丁	目2番3号	株
						式会社	コガネ	イ内		
				(74) f	理人	100080	0001			
						弁理士	筒井	大和 (外	2名)	
				Fタ-	-ム(参考) 2F	063 AA	02 BA05 CA34	CB01 CC05	
							DAG	05 DD03 GA52	LA27	
						2 F	077 AA	49 CCO2 JJO3]]09]]23	
							UU	09 VV01 VV 3 3		
						31	1081 AA	02 AA03 BB03	DD22 GG06	

(54) 【発明の名称】 位置検出装置およびその製造方法

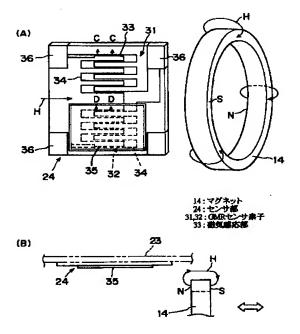
(57) 【要約】

【課題】 空気圧シリンダなどのアクチュエータのケーシングを小型化し得るようにする。

【解決手段】 アクチュエータのケーシングに往復動自在に装着された往復動部材としてのピストンロッドやピストンの位置を検出する。ピストンにはマグネット14が取り付けられており、ケーシングに取り付けられる検出器には、マグネット14の磁力に感応するGMRセンサ素子31を有するセンサ部24が設けられており、検出器は平板形となっている。平板形の検出器はケーシングの平坦面に取り付けられ、ピストンロッドの位置を検出する。

图 7

GG15 GG23



【特許請求の範囲】

【請求項1】 マグネットを有する往復動部材が往復動 自在に装着されたアクチュエータケーシングと、

1

前記アクチュエータケーシングに取り付けられ、前記マグネットの磁力に感応する磁気センサ素子が組み込まれたシート状の検出器を有し、

前記磁気センサ素子は前記マグネットの磁界方向とほぼ 平行の方向に伸びる磁気感応部を有することを特徴とす る位置検出装置。

【請求項2】 請求項1記載の位置検出装置において、前記検出器は実装基板と、該実装基板に配置される前記磁気センサ素子と、前記実装基板に配置され、前記磁気センサ素子からの信号を処理する制御部と、前記実装基板とにより前記磁気センサ素子および前記制御部を覆うカバーとを有し、前記検出器の厚みを1mm以下としたことを特徴とする位置検出装置。

【請求項3】 請求項1または2記載の位置検出装置において、前記検出器は対となってブリッジ回路を形成する複数の磁気センサ素子を有し、複数の磁気センサ素子のうち少なくとも1つを磁気遮蔽して前記マグネットの磁力に感応しない温度補正用としたことを特徴とする位置検出装置。

【請求項4】 請求項1~3の何れか1項に記載の位置 検出装置において、前記アクチュエータケーシングの外 周面は平坦面を有する断面角形であり、前記検出器を前 記アクチュエータケーシングの平坦な外周面に取り付け るようにしたことを特徴とする位置検出装置。

【請求項5】 請求項1~3の何れか1項に記載の位置 検出装置において、前記アクチュエータケーシングは前 記断面角形であり、前記アクチュエータケーシングの角 部に溝を形成し、該溝の中に前記検出器を取り付けるよ うにしたことを特徴とする位置検出装置。

【請求項6】 請求項1~5の何れか1項に記載の位置 検出装置において、複数の前記検出器を有し、ジグザグ 形状に折り曲げて形成された変形部内に組み込まれた信 号線により前記検出器を相互に接続し、前記変形部を引 き延ばすことにより複数の前記検出器の位置を変更し得 るようにしたことを特徴とする位置検出装置。

【請求項7】 請求項1~6の何れか1項に記載の位置 検出装置において、前記磁気センサ素子はGMRセンサ 素子であることを特徴とする位置検出装置。

【請求項8】 マグネットを有する往復動部材の位置を 検出する位置検出装置を製造する位置検出装置の製造方 法であって、

磁気センサ素子を有するセンサ部が配置された実装基板を準備する工程と、複数の前記実装基板をそれぞれ樹脂製のパッケージ内に封止して検出器を成形する工程と、複数の前記検出器が一体となった検出器群の状態のもとでそれぞれの検出器における前記センサ部の作動状態を検査する工程と、

検出器群から各々の検出器に分離する工程とを有することを特徴とする位置検出装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は流体アクチュエータ などのように往復動する部材の位置を検出する位置検出 装置およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】空気圧シリンダはケーシングの中にピストンロッドを直線方向に往復動自在に装着し、ケーシング内に空気圧を供給することによりピストンロッドを駆動するようにしている。

【0003】空気圧シリンダなどのように流体によって ピストンロッドなどの往復動部材を駆動するようにした アクチュエータにあっては、往復動部材が所定のストロ ーク端の位置まで移動したことを検出するために、ピス トンにマグネットを取り付け、マグネットの磁力に感応 する検出器をケーシングに設ける場合がある。

【0004】たとえば、半導体などの電子部品の組立を行うために使用する空気圧アクチュエータにあっては、高速で移動する部材に空気圧アクチュエータが装着されることがあり、アクチュエータの小型化および軽量化が望まれている。しかしながら、アクチュエータの推力はシリンダ孔の内径によって決定されるために、シリンダ孔の内径を小さくすることには限度がある。このため、内径を小さくすることなくシリンダを小型化するには、ケーシングの外径を小さくする必要があるが、前述のように、ピストンロッドが所定のストローク端となったことを検出する場合には、空気圧シリンダのケーシングに位置検出器を取り付ける必要があるためにケーシングの外径寸法を小型化するには限度があった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】つまり、従来では位置検出器にはマグネットの磁力に感応する強磁性体製の磁気抵抗素子(MR素子)が組み込まれているが、厚みを薄くするには限度があった。このため、たとえば、実用新案登録第2592877 号公報に開示されるように、ケーシングには断面U字形状のセンサ取付溝を形成したり、T字形状のセンサ取付溝を形成する必要があり、これらのセンサ取付溝は検出器の厚みに合わせて深い溝としなければならず、ケーシングを小型化することが困難であった。

【0006】一方、アクチュエータはコンピュータによって作動制御がなされており、制御系の省エネルギー化に伴い、直流二線式センサの漏れ電流、三線式センサの消費電流の低減化が重要となっている。

【0007】本発明の目的は、空気圧シリンダなどのアクチュエータのケーシングを小型化し得るようにすることにある。

50 【0008】本発明の他の目的は、位置検出器の薄形化

3

を達成することにある。

【0009】本発明の他の目的は、少ない消費電流によ ってアクチュエータの往復動部材の位置を検出し得るよ うにすることにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明の位置検出装置 は、マグネットを有する往復動部材が往復動自在に装着 されたアクチュエータケーシングと、前記アクチュエー タケーシングに取り付けられ、前記マグネットの磁力に 感応する磁気センサ素子が組み込まれたシート状の検出 10 器を有し、前記磁気センサ素子は前記マグネットの磁界 方向とほぼ平行の方向に伸びる磁気感応部を有すること を特徴とする。

【0011】本発明の位置検出装置は、前記検出器は実 装基板と、該実装基板に配置される前記磁気センサ素子 と、前記実装基板に配置され、前記磁気センサ素子から の信号を処理する制御部と、前記実装基板とにより前記 磁気センサ素子および前記制御部を覆うカバーとを有 し、前記検出器の厚みを1mm以下としたことを特徴とす る。

【0012】本発明の位置検出装置は、前記検出器は対 となってブリッジ回路を形成する複数の磁気センサ素子 を有し、複数の磁気センサ素子のうち少なくとも1つを 磁気遮蔽して前記マグネットの磁力に感応しない温度補 正用としたことを特徴とする。

【0013】本発明の位置検出装置は、前記アクチュエ ータケーシングの外周面は平坦面を有する断面角形であ り、前記検出器を前記アクチュエータケーシングの平坦 な外周面に取り付けるようにしたことを特徴とする。

【0014】本発明の位置検出装置は、前記アクチュエ ータケーシングは前記断面角形であり、前記アクチュエ ータケーシングの角部に溝を形成し、該溝の中に前記検 出器を取り付けるようにしたことを特徴とする。

【0015】本発明の位置検出装置は、複数の前記検出 器を有し、ジグザグ形状に折り曲げて形成された変形部 内に組み込まれた信号線により前記検出器を相互に接続 し、前記変形部を引き延ばすことにより複数の前記検出 器の位置を変更し得るようにしたことを特徴とする。

【0016】本発明の位置検出装置は、前記磁気センサ 素子がGMRセンサ素子であることを特徴とする。

【0017】本発明の位置検出装置の製造方法は、マグ ネットを有する往復動部材の位置を検出する位置検出装 置を製造する位置検出装置の製造方法であって、磁気セ ンサ素子を有するセンサ部が配置された実装基板を準備 する工程と、複数の前記実装基板をそれぞれ樹脂製のパ ッケージ内に封止して検出器を成形する工程と、複数の 前記検出器が一体となった検出器群の状態のもとでそれ ぞれの検出器における前記センサ部の作動状態を検査す る工程と、検出器群から各々の検出器に分離する工程と を有することを特徴とする。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面 に基づいて詳細に説明する。

【0019】図1(A)は本発明の一実施の形態である 位置検出装置を有する空気圧シリンダを示す斜視図であ り、図1(B), (C)はそれぞれ他のタイプの空気圧 シリンダを示す斜視図であり、図2(A)は図1(A) におけるA-A線に沿う断面図であり、図2(B)は同 図(A)におけるB-B線に沿う断面図である。

【0020】図1(A), (B) に示す空気圧シリンダ は、往復動部材としてのピストンロッド10とこれが直 線方向に往復動自在に装着されたアクチュエータケーシ ングとしてのケーシング11つまりシリンダ本体とを有 し、ピストンロッド10が所定の前進限位置つまり前進 ストローク端の位置となったことが検出される。ケーシ ング11は全体的に直方体形状となっており、ケーシン グ11は断面形状がほぼ四角形となっている。

【0021】ケーシング11には図2(B)に示すよう に断面円形のシリンダ孔12が形成され、ピストンロッ ド10の端部にはピストン13が固定されるとともに、 マグネット14が固定されている。ケーシング11の一 端部にはヘッドカバー15が取り付けられ、他端部には ピストンロッド10が貫通するロッドカバー16が取り 付けられており、それぞれのカバー15,16は止めリ ング17により固定されている。ただし、それぞれのカ バー15,16をねじ部材によりケーシング11の両端 にねじ止めするようにしても良く、ヘッドカバー15を ケーシング11と一体に形成するようにしても良い。

【0022】ケーシング11にはその一方の端面に開口 させて給排ポート18, 19が設けられており、一方の 給排ポート18はケーシング11に形成された流路を介 して一方の空気圧室18 a に連通され、他方の給排ポー ト19は流路を介して他方の空気圧室19aに連通され ている。ただし、それぞれの給排ポート18,19をケ ーシング11の外周面に開口させて形成するようにして も良い。

【0023】図1(A)に示すケーシング11は断面が ほぼ四角形となっているので、平坦な4つの外周面を有 しており、そのうちの1つの外周面には、ピストンロッ ド10が所定の前進限位置となったことを検出するため の平板形つまりシート状の検出器21が取り付けられて いる。検出器21をケーシング11の幅方向中央部に取 り付けると、図2(B)に示すように、その部分の肉厚 は他の部分よりも薄いので、内部のマグネット14に検 出器21を最接近させることができる。検出器21のケ ーシング11への取付は、接着剤や粘着テープなどによ って接着するようにしても良く、ねじ部品を用いて取り 付けるようにしても良い。ねじを用いて取り付ける場合 には検出器21にはねじが貫通する孔を形成することに 50 なる。

40

【0024】図1(B)に示すケーシング11の4つの角部のうち、1つの角部は他の角部よりも大きく切り欠かれて平坦な面取り部となっており、その面取り部に検出器21が取り付けられている。このように、面取り部に検出器21を取り付けることによって、検出器21をマグネット14に最接近させつつ、検出器21がケーシング11の外周面の外方に突出しないようにすることができる。

【0025】図1(A),(B)に示す空気圧シリンダにあっては、検出器21はピストンロッド10が前進限 10位置となったことを検出するために使用されているが、後退限位置と前進限位置とのいずれの位置についても検出する場合には、2つの検出器21がケーシング11に取り付けられることになる。

【0026】図1(C)はこのようにピストンロッド10が前進限位置と後退限位置とのいずれの位置となったときにも検出するために、2つの検出器21をケーシング11の角部に形成された面取り部に取り付けた場合を示す図であり、図1(A)に示すように面取り部に2つの検出器21を取り付けるようにしても良い。

【0027】図2(C)は図1(B)に示した空気圧シリンダを複数個並列に集積して配置した状態を示す図であり、それぞれの検出器21は、他の空気圧シリンダのピストン13の位置を検出することなく、対応したピストン13の位置を検出することができる。

【0028】図3は平板形の検出器21を拡大して示す 斜視図であり、ほぼ四角形の検出器21にはフラットケ ーブル22が接続され、検出器21からの出力信号は偏 平ケーブルつまりフラットケーブル22により外部の制 御機器に送られるようになっており、検出器21の厚み tは1mm以下となっている。したがって、検出器21は シート状ないし薄板状となっており、薄い検出器21を ケーシング11の外面に取り付けても、ケーシングを大 型にする必要がなく、ケーシングの小型化が達成され ス

【0029】図4は検出器21を分解して示す斜視図であり、検出器21はプリント配線が設けられた実装基板23を有し、この実装基板23にはセンサ部24とLED25と制御部26とが組み付けられており、実装基板23に設けられた凹部に固定されたフラットケーブル22の導体22aは、はんだ付けによりプリント配線に接続されている。実装基板23の図4における上面には物理的な緩衝材(図示省略)を介して磁気シールドシート27が積層されるようになっており、さらに、実装基板23の下側と磁気シールドシート27の上側には、樹脂製のカバー部材28,29が積層されるようになっている。これらのカバー部材28,29は、ICパッケージと同様に樹脂により成形することができる。磁気シールドシート27としては異方性の磁気シートを用いることも可能である。

【0030】図5は平板形の検出器21の製造工程を示す図であり、センサ部24、LED25および制御部26はそれぞれの製造工程により製造され、それぞれを実装基板23の上に配置してフラットケーブル22を溶接することにより、センサ部24などが配置された実装基板23が準備される。それぞれの実装基板23は複数の検出器21のサイズに対応したサイズのカバー部材28にそれぞれ固定される。この状態のもとで、磁気シールドシート27をのせ、次いで、コンプレッション成形法により上側のカバー部材29と下側のカバー部材28とをそれぞれの外周部で接合する。これにより、複数の大きな表基板23はそれぞれ同時に樹脂製のパッケージを構成する上下両側のカバー部材28、29の内部に封止され、複数の検出器21が一体となった検出器群が成形される。

【0031】図5にあっては、1つの検出器群が5つの 検出器21によって構成されているが、任意の数とする ことができ、複数の検出器21が1列となるようにして 1つの検出器群を成形するようにしても良く、図示する ように、フラットケーブル22が反対側となるようにし て、2列分を一体に成形するようにしても良い。

【0032】このようにして群となった状態のもとで、 検査工程に搬送され、センサ部24などの作動状態が検 査される。検査工程終了後には、複数の検出器21が一 体となった検出器群から各々の検出器21にダイシング などの技術によって分離される。

【0033】前述のようなコンプレッション成形法以外に、実装基板23を射出成形金型に配置して外側にカバーをモールド成形するようにしても良い。いずれの成形方法であっても、カバー部材28,29の厚みが薄くなるので、LED25が点灯すると、カバー部材29を不透明な材料としても、LED25が点灯したことを外部から目視することができる。ただし、上側のカバー部材29を透明材料としても良い。

【0034】図6は本発明の他の実施の形態である検出装置の製造方法を示す工程図であり、この場合には、センサ部24などが実装された実装基板23は予め所定のサイズに切断されたカバー部材28の上に固定される。それぞれカバー部材28に固定された実装基板23は、ポリエステル樹脂などからなる樹脂製シート30の上に配置される。この状態のもとで、磁気シールドシート27と上側カバー部材29とを載置し、コンプレッション成形法により上側のカバー部材29と下側のカバー部材28とをそれぞれの外周部で接合する。

【0035】このようにして両方のカバー部材28,29によって樹脂封止された検出器21の動作が検査された後に、各々の検出器21の分離操作が行われるが、各々の検出器21を樹脂製シート30から剥離するようにしても良く、樹脂製シート30を切断してカバー部材28に付着させたままとしても良い。

50

20

【0036】この検出器21は、図4における下側のカバー部材28の部分でケーシング11の外周面に取り付けられるようになっており、検出器21の下側面が検出面となっている。したがって、磁気シールドシート27はセンサ部24の外側に覆われて、外部からの磁気ノイズがセンサ部24に入り込むのを防止することになる。磁気シールドシート27の積層に代えて、軟磁性体のパウダーと接着剤との混合物をセンサ部24などを覆うように実装基板23の上に塗布するようにしても良い。また、カバー部材28,29を樹脂材料を用いることなく、染料を含むエポキシ樹脂材料に軟磁性体の粉末を混合し、この混合物をモールド材料としても良く、その場合には成形金型を磁化させて磁界の中でモールドし、カバー部材28,29を規則的に磁化させるようにしても良い。

7

【0037】図7(A)は図4に示されたセンサ部24を拡大して示す斜視図であり、同図(B)は同図(A)の平面図であり、図8(A)は図7(A)におけるC-C線に沿う拡大断面図であり、図8(B)は図7(A)におけるD-D線に沿う拡大断面図である。

【0038】このセンサ部24はGMR特性 (giant ma gnetoresistive characteristic)、つまり巨大磁気抵抗 効果特性のセンサ素子31,32を有している。センサ 素子31,32としては、強磁性体からなる磁気抵抗素 子つまり磁気センサ素子を使用することも可能である が、図示するセンサ素子としては、巨大磁気抵抗特性の ものが使用されている。それぞれのGMRセンサ素子3 1,32は金属磁性層Aと金属非磁性層Bとを交互に多 層に積層して形成された人口格子MR膜となっており、 金属磁性層AとしてはNiFeCo系のNi合金が使用され、金 属非磁性層BとしてはCuが使用されている。金属磁性層 Aの厚みは2.2 ~2.4nm であり、金属非磁性層Bの厚み は1.9 ~2.1nm となっており、これらが合計30層形成 されている。これらのGMRセンサ素子の膜は、アルミ ナ(Al₂O₃) やSiのサブストレートつまり基板Sの上にガ ラス膜を形成したり研磨加工することにより基板Sの表 面を平坦化した後にDCスパッタリングなどのスパッタ リングの技術により成膜されている。GMRセンサ素子 膜の表面には、SiO₂ などにより絶縁膜Pが成膜される。 GMRセンサ素子膜の厚み t_1 は 1μ m以下であり、絶縁 40 膜Pの厚みは25μm程度である。

【0039】GMRセンサ素子は抵抗値が数100KΩ程度であり、強磁性体からなる磁気抵抗素子に比して10倍程度の高い抵抗値を有しており、電流値が小さくので消費電流を少なくすることが可能となる。

【0040】それぞれのGMRセンサ素子31,32 は、全体的にジグザグ状つまり九十九折り状に蛇行して 形成されており、それぞれ相互に平行となった7本の磁 気感応部33と、隣り合う磁気感応部33の一端部を接 続する導通部34とを有している。ただし、磁気感応部50 33の本数は任意の数とすることができる。

【0041】図7に示すマグネット14はリング状となっており、両端面に極性が着磁され、マグネット14により形成される磁界の方向がHであるとすると、磁気感応部33が磁界の方向Hと平行となるように、検出器21はケーシング11に取り付けられるようになっている。マグネット14はセンサ部24の検出面の前方を白抜きの矢印で示すように、ピストン13によって往復動することになる。

【0042】GMRセンサ素子の磁気感応部33が磁界の方向に平行となるようにすると、従来の磁気抵抗素子に比して10倍の感度が得られることになり、ピストンなどの往復動部材に装着されるマグネット14を小型としたり、発生させる磁力が小さいものを使用することも可能となる。これにより、図2(C)に示すように空気圧シリンダを複数個並列にして集積して使用しても、1つの空気圧シリンダに対応した検出器21が他の空気圧シリンダのピストンを検出することが防止され、空気圧シリンダの鬼積化ないし集合化が可能となる。

【0043】図7に示すセンサ部24はそれぞれGMRセンサ素子31,32を有し、これらによってハーフブリッジ回路を形成しているが、一方のGMRセンサ素子32は温度補正用として使用されている。したがって、マグネット14の磁界がセンサ素子32に作用しないように、センサ素子32の表面つまりマグネット14側の面には磁気遮蔽用の磁気シールドシート35が設けられている。この磁気シールドシート35は磁性体薄膜によって形成されており、蒸着や電着などの技術により形成することができる。したがって、マグネット14の磁力には一方のセンサ素子31のみが感応して抵抗値が変化する。両方のセンサ素子31,32の温度条件は同一となるので、温度による抵抗値の変化は相殺され、ゼロ点温度特性を補償することが可能となる。

【0044】図7に示すように、基板にはハーフブリッジ回路を構成する2つのGMRセンサ素子31、32の端子に接続される端子電極36が設けられている。なお、磁気シールドシート35の厚み t_2 は t_1 の10倍程度に設定されており、マグネット14の着磁面が磁気シールドシート35に対向するように検出器21はケーシング11に取り付けられることになる。

【0045】図9(A),(B)はセンサ部24の回路構成を示す図であり、それぞれ4つの抵抗によってフルブリッジ回路が構成されている。図9(A)に示す場合には、1つのみがGMRセンサ素子31となっており、他の3つの抵抗としてはGMRセンサ素子以外の他の抵抗体が使用されている。これに対して、図9(B)に示す場合には、2つの抵抗がGMRセンサ素子31,32により形成され、他の2つの抵抗はGMRセンサ素子以外の他の抵抗体が使用されている。GMRセンサ素子32の表面に図7に示すように磁気シールドシート35を

積層して無感度とすることにより、前述したようにゼロ 点温度特性を補償したタイプのセンサ部24となる。

9

【0046】図10はフルブリッジ回路のセンサ部24からの制御信号を処理する制御部26の回路構成を示すブロック図であり、センサ部24からの出力信号は差動増幅器41で増幅された後に比較器42でしきい値と比較される。ピストンロッド10が所定の位置まで移動したときには、マグネット14の磁力によって比較器42から出力部43に検出信号が送られ、出力部43からは外部の制御機器にフラットケーブル22を介して出力信10号が送られることになる。比較器42からの検出信号は、LEDへの出力回路44にも出力されて、位置検出が行われたときには、LED25が点灯することになる。センサ部24などに対する電力の供給は、内部電源部45から供給されるようになっている。

【0047】図11(A),(B)は本発明の他のタイプの検出器21を示す図であり、図7に示す場合には2つのGMRセンサ素子31,32を1つの基板に形成するようにしているが、図11(A)に示すように、1つのGMRセンサ素子31を1つの基板に形成するようにしても良く、このタイプの検出器21にあっても、図11(B)に示すように、GMRセンサ素子32の表面に磁気シールドシート35を積層すれば無感度の抵抗体を得ることができる。

【0048】図12は他のタイプのマグネット14を示す図であり、このマグネット14は図7に示したものがリング状であるのに対して、チップ状つまり小片状となっており、センサ部24に対向する面に極性が着磁されている。

【0049】図13はさらに他のタイプのマグネット14を示す図であり、図12に示したものと同様にマグネット14はチップ状となっているが、この場合には、その着磁面の移動方向の中央部を両極性の境界とし、両端部には着磁ピッチを小さくしてN極とS極とが交互に着磁されている。このように、マグネット14の移動方向の両端部における着磁ピッチを小さくすると、センサ部24から検知した磁力に応じて出力される信号の中に不安定要因が含まれることを防止できる。

【0050】図14(A)は図12に示したマグネット14を用いた場合におけるセンサ部24からの出力信号の波形を示す図であり、出力値が所定のしきい値を超えた場合には、制御部26から検知信号が出力されることになるが、図12に示したマグネット14の場合には、所定の位置の前後にしきい値よりも低い出力波形がセンサ部24から出力されることになる。

【0051】これに対して、図13に示したマグネット 14を使用した場合には、図14(B)に示すように、 検出位置の前後には不安定な出力信号がセンサ部24か ら出力されなくなり、しきい値を下げることが可能とな るとともに、センサの誤作動を防止することができる。 【0052】図15は本発明の他の実施の形態である位置検出装置を示す図であり、この場合にはケーシング11の外周面には、ピストンロッド10が前進限位置となったことと、後退限位置となったことの両方を1つの検出器21によって検出するようにしている。

10

【0053】この検出器21は第1検出器21aと第2検出器21bの2つを有し、それぞれの検出器21a,21bは図4に示したものとほぼ同様の構造となっている。2つの検出器21a,21bはジグザグ状つまり九十九折り状となった変形部51により接続されており、図16(A),(B)に示すように、内部に封入された信号線52によって両方の検出器は電気的にも接続されている。

【0054】変形部51は容易に弾性変形あるいは塑性変形自在のゴムや樹脂などの変形自在の材料によりなる帯状の部材からなり、図16(A)に示すように、両側から交互にスリット53が形成されている。したがって、収縮させた状態では図16(A)に示すように、スリット53が閉じられた状態となっているが、両方の検出器21a,21bを引き離すと、図16(B)に示すように、スリット53が広がって両方の検出器21a,21bの間隔を任意に設定することができる。

【0055】このように、それぞれ2線式の2つの検出器21a,21bを接続した構成とすると、それぞれの検出器に対する信号線は、共通線を使用して3本とすることができ、しかも、束ねられた1つのフラットケーブルを用いて2つの検出器からの出力信号を外部の制御部に送ることができる。

【0056】図15に示す空気圧シリンダにあっては、 ピストンロッド10の断面形状が四角形となっている が、断面円形としても良い。

【0057】図17(A)は本発明の他のタイプの検出器21を示す図であり、この検出器21はケーシング11に一端から他端に連なって形成されたセンサ取付溝54に非鉄金属製のねじ部材55により固定されるようになっている。センサ取付溝54の断面形状としては、図17(B)に示すように、検出器21の表面に接触する面54aをテーパ形状としても良い。

【0058】図17(C)は図17(A)に示した検出器21を示す図であり、この検出器21の表面にはアルミニウム製あるい樹脂製の補強部材56が設けられており、この補強部材56を含めて厚み方向に貫通するねじ孔57が検出器21に設けられている。ただし、補強部材56を設けることなく、検出器21を樹脂パッケージ内に封入し、パッケージを貫通するようにねじ孔57を形成するようにしても良い。

【0059】本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

【0060】たとえば、図示する実施の形態にあって

は、空気圧シリンダのピストンロッドないしピストンの 位置を検出するために本発明を適用しているが、揺動アクチュエータや油圧シリンダなどのように、ケーシング ないしハウジングつまり装置本体内に往復動する部材が 組み込まれ、その位置を検出する場合であれば、どのようなものでも適用することができる。また、磁気センサ31,32としては、磁界に感応して信号を出力するものであれば、GMRセンサ以外の磁気抵抗素子を使用することができる。

[0061]

【発明の効果】本発明にあっては、検知器を平板形としたので、ケーシングに検知器を取り付けても、検知器がケーシングの外面から外方に突出することなく、ケーシングを小型化することができる。

【0062】検知器内のセンサ部を磁気センサ素子により形成したので、往復動部材に取り付けられるマグネットを小型化したり、磁力の小さいものにしても、確実に往復動部材が所定の位置となったことを検出することができる。

【0063】ケーシングに複数の検知器を取り付ける場 20 合でも、複数の検知器を変形部で接続することにより、 束ねられた状態の1つのフラットケーブルで外部の制御 機器に出力信号を送ることができる。

【0064】磁気センサ素子として、GMRセンサ素子を使用することにより、センサ部の薄膜化をより達成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(A)は本発明の一実施の形態である位置検出 装置を有する空気圧シリンダを示す斜視図であり、

(B), (C) はそれぞれ他のタイプの空気圧シリンダ 30 を示す斜視図である。

【図2】(A)は図1(A)におけるA-A線に沿う断面図であり、(B)は同図(A)におけるB-B線に沿う断面図であり、(C)は他のタイプの空気圧シリンダを複数個集積した状態を示す断面図である。

【図3】検出器を拡大して示す斜視図である。

【図4】シート状の検出器を分解して示す斜視図である。

【図5】平板形の検出器の製造手順の一実施の形態を示す斜視図である。

【図6】平板状の検出器の他の実施の形態である製造手順を示す工程図である。

【図7】 (A) は図4に示されたセンサ部を拡大して示す斜視図であり、(B) は同図(A) の平面図である。

【図8】 (A) は図7におけるC-C線に沿う拡大断面図であり、(B) は図7におけるD-D線に沿う拡大断面図である。

【図9】(A), (B)はそれぞれセンサ部の回路構成を示すブロック図である。

【図10】センサ部からの制御信号を処理する制御部の 回路を示すブロック図である。

10 【図11】(A), (B) はそれぞれ他のタイプの検出 器を示す斜視図である。

【図12】 (A) は他のタイプのマグネットを示す斜視図であり、(B) は同図(A) の平面図である。

【図13】 (A) は他のタイプのマグネットを示す斜視 図であり、(B) は同図(A) の平面図である。

【図 1 4 】 (A), (B) はそれぞれセンサ部の出力特性を示す線図である。

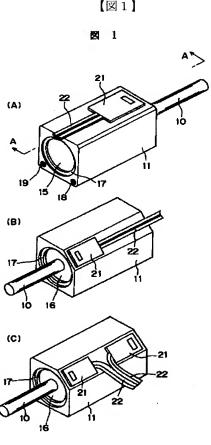
【図 1 5 】本発明の他の実施の形態である位置検出装置を示す斜視図である。

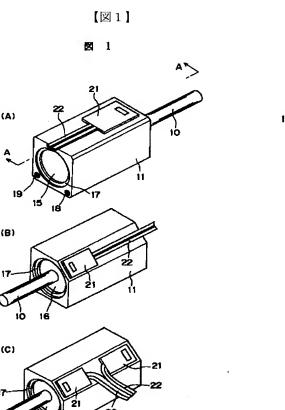
【図16】(A), (B)はそれぞれ図15に示した変形部の変形状態を示す平面図である。

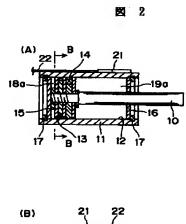
【図17】(A)は他のタイプの検出器が装着された状態のケーシングの一部を示す断面図であり、(B)はさらに他のタイプの検出器が装着された状態のケーシングの一部を示す断面図であり、(C)は(A)、(B)に示された検出器を示す斜視図である。

【符号の説明】

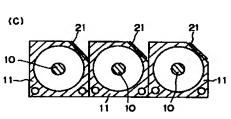
- 10 ピストンロッド(往復動部材)
- 11 ケーシング
- 13 ピストン
- 14 マグネット
- 21 検出器
- 22 フラットケーブル
- 23 実装基板
- 24 センサ部
- 26 制御部
- 27 磁気シールドシート
- 28, 29 カバー部材
- 31,32 GMRセンサ素子
- 40 33 磁気感応部
 - 3 4 導通部
 - 5 1 変形部

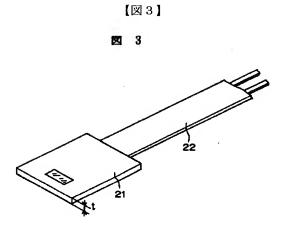


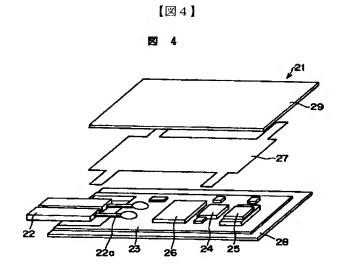




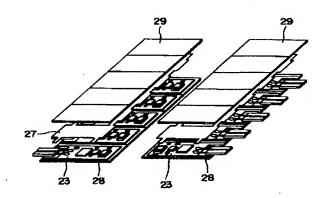
【図2】

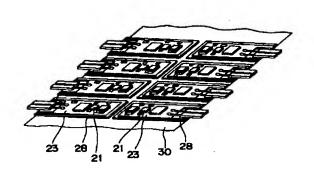




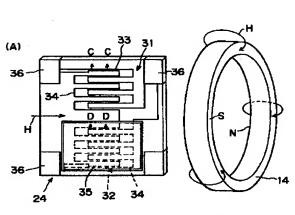


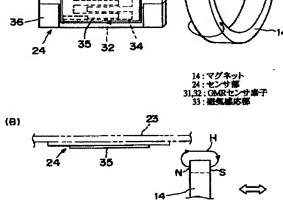
[図5] 【図6] **図** 5

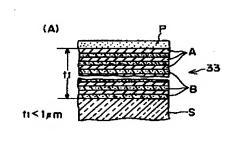




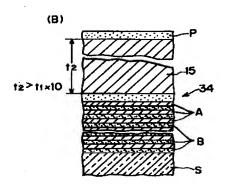


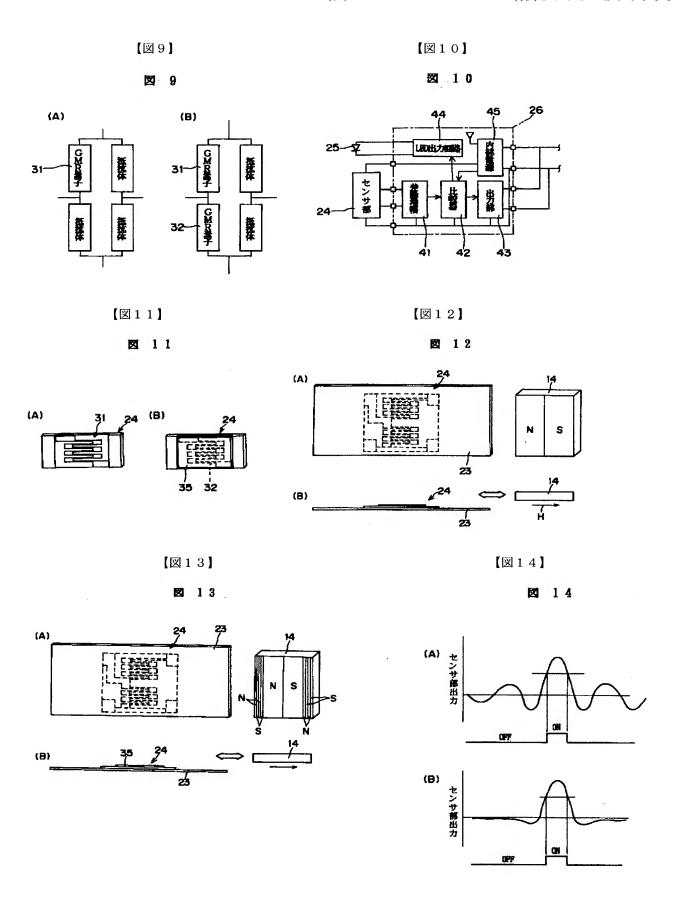






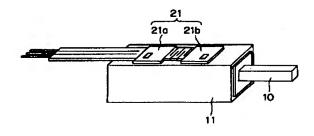
【図8】





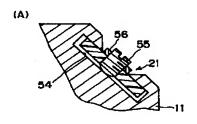
【図15】

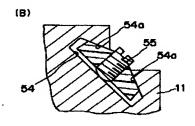
図 15

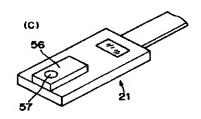


【図17】

图 17

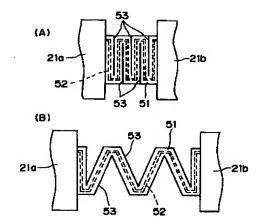






【図16】

2 16



フロントページの続き

(51) Int. C1. TG 0 1 D 5/245

識別記号

FΙ

G 0 1 D 5/245

テーマコード(参考)

R